



PRODUKTINFORMATION

SM Gap Pad 2,0-0500-SI Thermisch leitfähiger Gap-Filler aus Silikon

SM Gap Pad ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine außergewöhnlich hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch einen einseitig aufgetragenen wärmeleitenden Film ist das Material einseitig nicht haftend.

Technische Daten

Physisch	
Farbe	hellblau/grau
Gesamtdicke	0,5 mm
Material	Silikon mit Keramikfüllung
Mechanisch	
Härte nach Shore 00	20
Thermisch	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +200 °C
Thermische Leitfähigkeit	2,0 W/mK
Wärmewiderstand, 70 kPA, Dicke 0,49 mm	0,74 °C-inch ² /W
Elektrisch	
Durchgangswiderstand	> 1,0 x 10 ¹⁰ Ωcm
Durchschlagsfestigkeit	> 10 kV/mm
Spezifikationen	
Entflammbarkeit	UL94 V0
RoHS-Konformität	2011/65/EU

Revision: sk, 05/2021

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.